



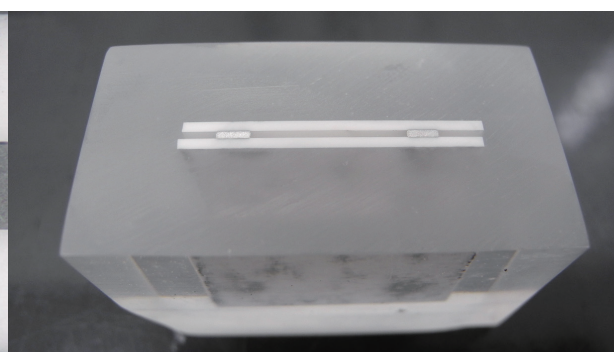
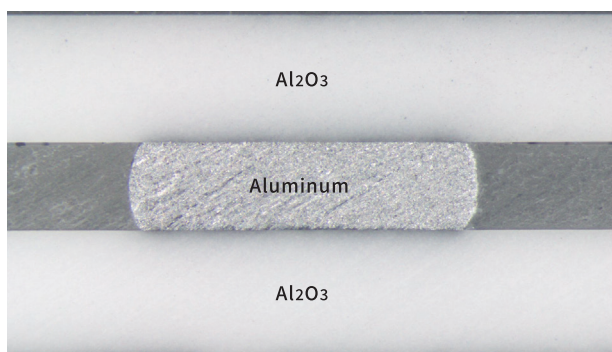
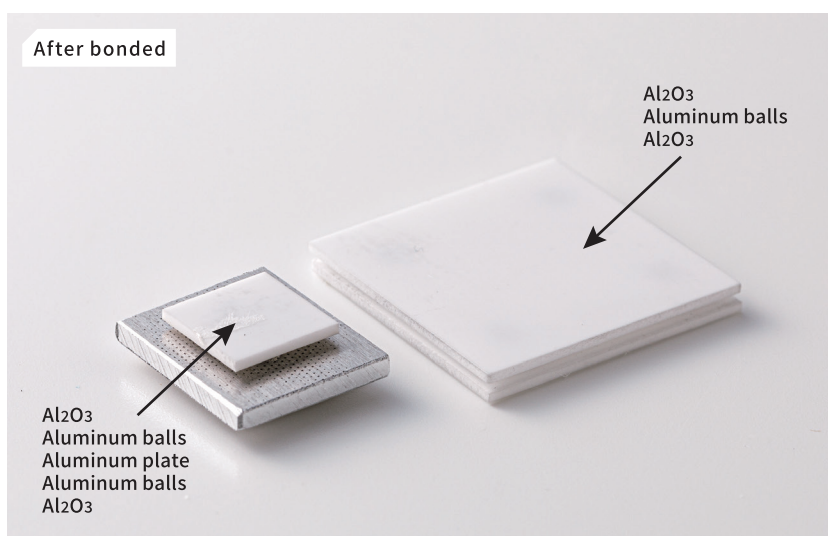
Patented

Application

Bonding ボンディング

アルミボールでアルミナ基板を音波積層接合

サウンドパワーの綺麗な拡散接合



Product used 使用する装置

15MZs



AP-J-0105A4-2023062101